

1. Отверджувана композиція для нанесення на керамічні або скляні підкладки, що містить щонайменше одне здатне отверджуватися зв'язуюче та множину частинок, у якій частинки є твердими і зв'язуюче є неотвержде при першій температурі або нижче першої температури, при якій композиція може бути нанесена на підкладку, і частинки розм'якшені при другій температурі або нижче другої температури, при якій твердне органічне зв'язуюче.
2. Композиція за п. 1, у якій різниця між першою температурою та другою температурою становить щонайменше 30 °C.
3. Композиція за п. 1, у якій різниця між першою температурою та другою температурою становить щонайменше 50 °C.
4. Композиція за п. 1, у якій принаймні деякі з частинок містять органічний матеріал.
5. Композиція за п. 4, у якій органічним матеріалом є поліамід.
6. Композиція за п. 4, яка додатково містить неорганічні частинки та/або інші органічні частинки.
7. Композиція за п. 1, у якій частинки складають від 5 до 50 % маси композиції.
8. Композиція за п. 1, у якій частинки складають від 10 до 35 % маси композиції.
9. Композиція за п. 1, у якій здатне отверджуватися органічне зв'язуюче містить смолу з поліепоксифункціональною групою.
10. Композиція за п. 9, у якій зв'язуюче додатково містить отверджувальний агент із амінними функціональними групами.
11. Композиція за п. 9, у якій здатне отверджуватися органічне зв'язуюче додатково містить блокований поліізоціанат.
12. Композиція за п. 1, яка додатково містить барвну речовину.
13. Композиція за п. 12, у якій барвною речовиною є органічний пігмент.
14. Композиція за п. 12, у якій барвною речовиною є неорганічний пігмент.
15. Композиція за п. 1, яка додатково містить пігмент, що створює спеціальний ефект.
16. Спосіб нанесення покриття на керамічну підкладку, який включає:
  - (a) нанесення на принаймні частину підкладки композиції, що включає принаймні одне здатне тверднути органічне зв'язуюче та множину частинок, що є тверді при першій температурі або нижче першої температури та розм'якшені при другій температурі, яка дорівнює або нижче температури, при якій твердне зв'язуюче; і
  - (b) отвердіння зв'язуючого з утворенням шару покриття.
17. Спосіб за п. 16, у якому композиція додатково містить барвну речовину.
18. Спосіб за п. 16, у якому здатне отверджуватися органічне зв'язуюче містить смолу з поліепоксифункціональною групою.

19. Спосіб за п. 16, у якому названа стадія нанесення покриття включає трафаретний друк гарячого розплаву названої композиції на названу підкладку.
20. Спосіб за п. 16, у якому керамічною підкладкою є скло.
21. Спосіб за п. 16, у якому перед стадією (а) керамічну підкладку додатково обробляють композицією для поліпшення видалення отвердженої композиції від підкладки.
22. Спосіб за п. 16, у якому керамічною підкладкою є скляна пляшка.
23. Спосіб за п. 18, у якому здатне отверджуватися органічне зв'язуюче додатково містить блокований полізоціанат.
24. Спосіб за п. 21, у якому композиція для поліпшення видалення отвердженої композиції від підкладки включає поліетилен.
25. Спосіб за п. 16, у якому композиція містить від 10 до 35 % мас. частинок.
26. Спосіб нанесення покриття на керамічну підкладку, який включає:
  - (а) послідовне нанесення на принаймні частину підкладки двох або більше композицій, які включають щонайменше одне здатне отверджуватися органічне зв'язуюче та множину частинок, які є тверді при першій температурі або нижче першої температури та розм'якшені при другій температурі, яка дорівнює або нижче температури, при якій твердне зв'язуюче композиції, де кожна композиція може бути тією ж самою або відмінною від іншої композиції і де композиція, що наносить останньою, необов'язково може включати згадану множину частинок, і
  - (б) практично одночасне отвердіння зв'язуючих у композиціях з утворенням шарів покриття.
27. Спосіб за п. 26, у якому щонайменше одна з композицій додатково містить барвну речовину.
28. Спосіб за п. 26, у якому здатне отверджуватися органічне зв'язуюче містить смолу з поліепоксифункціональною групою.
29. Спосіб за п. 28, у якому здатне отверджуватися органічне зв'язуюче додатково містить блокований полізоціанат.
30. Спосіб за п. 26, у якому названа стадія нанесення покриття включає трафаретний друк гарячого розплаву названої композиції на названу підкладку.
31. Спосіб за п. 26, у якому керамічною підкладкою є скло.
32. Спосіб за п. 26, у якому перед стадією (а) керамічну підкладку додатково обробляють композицією для поліпшення видалення отвердженої композиції від підкладки.
33. Спосіб за п. 32, у якому композиція для поліпшення видалення отвердженої композиції від підкладки включає поліетилен.
34. Спосіб за п. 26, у якому керамічною підкладкою є скляна пляшка.
35. Спосіб за п. 26, у якому композиція містить від 10 до 35 % мас. частинок.

- 36. Керамічна підкладка з покриттям, нанесеним відповідно до способу за п. 16.
- 37. Керамічна підкладка з покриттям, нанесеним відповідно до способу за п. 26.
- 38. Керамічна підкладка з покриттям, нанесеним відповідно до способу за п. 21.
- 39. Керамічна підкладка з покриттям, нанесеним відповідно до способу за п. 32.
- 40. Керамічна підкладка з покриттям, нанесеним відповідно до способу за п. 25.
- 41. Керамічна підкладка з покриттям, нанесеним відповідно до способу за п. 35.
- 42. Спосіб нанесення покриття на керамічну підкладку, який включає:

- (a) послідовне нанесення на принаймні частину підкладки двох або більше композицій, які включають щонайменше одне здатне отверджуватися органічне зв'язуюче та множину частинок, які є тверді при першій температурі або нижче першої температури та розм'якшені при другій температурі, яка дорівнює або нижче температури, при якій твердне зв'язуюче композиції, де кожна композиція може бути тією ж самою або відмінною від іншої композиції і де остання композиція, що наносять, необов'язково може включати зазначену множину частинок, і
- (b) практично одночасне отвердіння композицій при температурах, що дорівнюють або нижче 325 °C.